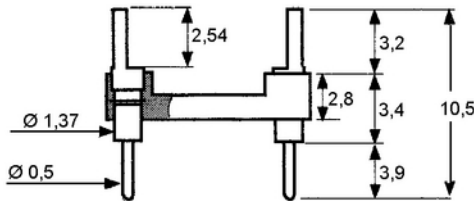


### Technische Daten / Technical Data

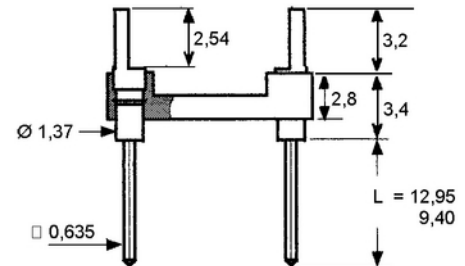
Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to plating options, over Ni</i>
Lötbarkeit <i>Solderability</i>	IEC 60512-12A <i>IEC 60512-12A</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 10mΩ <i>&lt; 10mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ <i>&gt; 1000MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1kV <sub>RMS</sub> <i>1kV<sub>RMS</sub></i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	100V <sub>RMS</sub> / 150V <sub>DC</sub> <i>100V<sub>RMS</sub> / 150V<sub>DC</sub></i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1A <i>1A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55°C ... +125°C <i>-55°C ... +125°C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

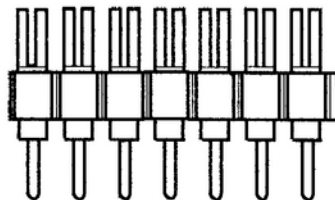
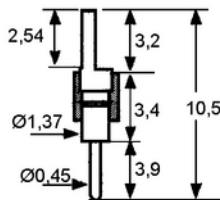


**IC-Fassung Serie 175**  
**IC-Socket Series 175**

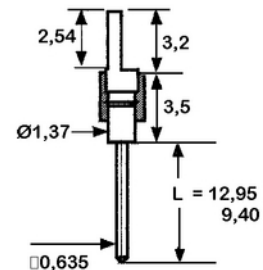


**Wire-Wrap Anschluß**  
**Wire-Wrap Type**

**Einlötlanschluß**  
**Solder Type**



**IC-Leiste Serie 188**  
**IC-Strip Series 188**



Series	Contacts*	DIP*	Terminals*	Plating*
<b>175</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
175 IC-Fassungen IC Sockets	06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 28 20 22 24 28 32 10 24 28 32 36 40 42 48 50 52 50 52 64	3 7,62mm 4 10,16mm 6 15,24mm 9 22,86mm	10 L=3,90, Ø0,50mm 20 L=9,40, Sq0,635mm WireWrap 30 L=12,95, Sq0,635mm WireWrap	10 Feder vergoldet 0,25µm 10µ" gold plated clip 30 Feder vergoldet 0,75µm 30µ" gold plated clip 50 Verzinkt Tin plated
Series	Contacts*	Rows*	Terminals*	Plating*
<b>188</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
188 IC-Leisten IC Headers	01-64 Einreihig Single row 02-64 Zweireihig Double row	1 Einreihig Single row 2 Zweireihig Double row	10 L=6,60, Ø0,50mm 20 L=9,40, Sq0,635mm WireWrap 30 L=12,95, Sq0,635mm WireWrap	10 Feder vergoldet 0,25µm 10µ" gold plated clip 30 Feder vergoldet 0,75µm 30µ" gold plated clip 50 Verzinkt Tin plated

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** - please replace by your specifications.

## Informationen zum Wellen-Lötverfahren Wave Soldering Information

### Empfehlungen für das Wellenlötverfahren Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.  
*Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.*

Empfohlenes Wellenlötprofil:  
*Recommended wave soldering profile:*



## Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

### Reflow-Löttempfehlung Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

